

日月光一〇〇年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 100 年 8 月 4 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇〇年度第二季及上半年獲利報告，本公司一〇〇年第二季之合併營業收入較一〇〇年第一季成長 1%，與九十九年同期持平，為新台幣 46,254 百萬元。茲將日月光一〇〇年度第二季單季及上半年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第二季	100 年度 第一季	99 年度 第二季	100 年度 上半年	99 年度 上半年
營業收入	46,254	46,005	46,416	92,259	83,971
營業毛利	8,964	8,658	9,916	17,622	17,472
營業淨利(淨損)	4,621	4,387	5,763	9,008	10,042
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,749	5,096	5,383	9,845	9,457
所得稅利益(費用)	(998)	(963)	(611)	(1,961)	(1,067)
少數股權純損(益)	(107)	(159)	(159)	(266)	(382)
本期淨利(淨損)	3,644	3,974	4,613	7,618	8,008
稀釋每股盈餘(元)	0.60	0.65	0.76	1.25	1.34

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第二季	100 年度 第一季	99 年度 第二季	100 年度 上半年	99 年度 上半年
營業收入	32,255	30,879	31,697	63,134	59,120
營業毛利	7,533	7,095	8,303	14,628	14,750
營業淨利(淨損)	4,334	3,970	5,367	8,304	9,186
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,580	4,774	5,176	9,354	9,108
所得稅利益(費用)	(832)	(645)	(525)	(1,477)	(921)
少數股權純損(益)	(104)	(155)	(38)	(259)	(179)
本期淨利(淨損)	3,644	3,974	4,613	7,618	8,008
稀釋每股盈餘(元)	0.60	0.65	0.76	1.25	1.34

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	50
個人電腦	15
汽車及消費性電子產品	34
其他	1
前十大客戶佔營收比重	45

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	54
歐洲	12
台灣	21
日本	7
亞洲其他地區	6

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	81
Traditional leadframe based	10
Module assembly	6
Others	3
封裝資本支出金額	220 百萬美元
打線機台數	13,015 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	87
晶圓測試	11
前段測試	2
測試資本支出金額	63 百萬美元
測試機台數	2,408 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	34
電腦產品	21
消費產品	21
工業產品	14
汽車電子產品	10
其他	0
前十大客戶佔營收比重	77
EMS 資本支出金額	4 百萬美元